



(11) **EP 2 962 799 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
B23K 20/10 ^(2006.01) **B23K 37/06** ^(2006.01)
H01R 43/02 ^(2006.01) **H01L 23/00** ^(2006.01)
H01L 23/48 ^(2006.01) **H01L 23/498** ^(2006.01)
H01L 21/48 ^(2006.01) **B23K 26/12** ^(2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
12.10.2016 Patentblatt 2016/41

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
07.09.2016 Patentblatt 2016/36

(21) Anmeldenummer: **14175716.1**

(22) Anmeldetag: **04.07.2014**

(54) **Halbleitermodul mit Ultraschall geschweißten Anschlüssen**

Semiconductor module with ultrasound welded connections

Module semi-conducteur doté de raccords soudés aux ultrasons

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

- **Hajas, David**
5102 Rapperswil (CH)
- **Thut, Markus**
5703 Seon (CH)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.01.2016 Patentblatt 2016/01

(74) Vertreter: **ABB Patent Attorneys**
c/o ABB Schweiz AG
Intellectual Property CH-IP
Brown Boveri Strasse 6
5400 Baden (CH)

(73) Patentinhaber: **ABB Schweiz AG**
5400 Baden (CH)

(72) Erfinder:

- **Hartmann, Samuel**
5603 Staufien (CH)
- **Guillon, David**
8857 Vorderthal (CH)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A1-102006 026 659 DE-A1-102010 005 043
US-A- 5 115 961

EP 2 962 799 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).